

# 测试题

## 填空题 (2\*20)

1. 表面组装技术是：\_\_\_\_\_。
  2. SMT 技术的优点：\_\_\_\_\_。
  3. 在 \_\_\_\_\_ 技术中起到的作用是：\_\_\_\_\_。
  4. SMT 一线体设备局是：\_\_\_\_\_。
  5. SMT 表面组装单面锡膏工艺流程顺序：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。
- 智能制造 SMT 技术制造生活中的产品，举五种以上：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。
- 涂覆料锡膏的重要特性：\_\_\_\_\_。
- 以下单位进算  
 $\Omega$  \_\_\_\_\_  $\Omega$  \_\_\_\_\_  $\Omega$  × \_\_\_\_\_
- 英制转化为公制：  
\_\_\_\_\_ 的电料尺寸为：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_ 电料尺寸：\_\_\_\_\_。
- 电表面电值：\_\_\_\_\_，电值：\_\_\_\_\_。
- 396 无焊料锡膏比例是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- \_\_\_\_\_ 技术中见的缺陷有哪些：\_\_\_\_\_。
- 表面组装元器件类可为：\_\_\_\_\_。
- 见的电防品：\_\_\_\_\_。
- 中文全称：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_。
- 出色环电：橙绿紫灰的值：\_\_\_\_\_。
- 中的板的特点：\_\_\_\_\_。
- 锡膏的熔点：\_\_\_\_\_，无锡膏的熔点：\_\_\_\_\_。
- 见的生产片式电元器件包装：\_\_\_\_\_。
- 金属模板 ( ) 制造方法：\_\_\_\_\_。

## 二、简答题 (60)

1、表面组装技术的组成包含哪些？ ( )

2、DEK 全自动机的部结构包含哪些？并说各部位的功能是什么？ (12)

3、 SMT 中使 的元器件 哪些要求？（8）

、 术中 参数 哪些？其中 可根 工艺文件 整的参数 几个？（8）

、 中双面工艺 几种？ 是哪些？并详细 出当 最 见的工艺顺 。（ ）

见的制程缺 析方法鱼 图法是从哪几个方面来 析制程中出现的缺 ？并使  
鱼 图试 析 术中出现的少锡 况。（ ）